

# 2020年9月上海电子封装测试展览会

产品名称	2020年9月上海电子封装测试展览会
公司名称	旻生展览（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	021-56802386 15001909485

## 产品详情

2020上海电子封装测试展览会

Shanghai international exhibition of electronic packaging testing 2020

### ≡ 基本信息 ≡

展览时间：2020年9月15-19日

展览地点：国家会展中心（上海）

展出面积：预计超过28,0000平方米

观众数量：预计超过17,0000人次海内外专业人士，来自50+国家或地区

### ≡ 组织机构 ≡

主办机构：

德国汉诺威展览公司

东浩兰生（集团）有限公司

承办机构：

上海工业商务展览有限公司

执行机构：

上海昶文展览服务有限公司

## ▣ 展会背景 ▣

当今中国已成为世界最大电子信息产品的制造国之一，众多世界著名电子公司的大量一级、二级封装正在转入我国生产，如今封装测试、烧结技能已演变成半导体、LED、电子领域一颗明珠，是集成电路芯片生产完成后不可缺少的一道工序，是器件到系统的桥梁。为本行业及上下游行业提供信息交流，市场开拓和经营决策、产品展示、技术开发的平台，为企事业单位、科研院所和高等院校搭建桥梁。

2020上海国际电子封装测试展览会将于2020年9月15日至19日在国家会展中心（上海）举行，上海国际电子封装测试展览会是"2020上海国际工业博览会-新材料展"旗下的一个专题展，是中外电子封装材料行业集形象展示、品牌推广、市场营销、技术交流于一体的实效交流平台，届时，热忱欢迎国内外的电子封装企业及其相关行业人士前来参观与交流！

## ▣ 参展范围 ▣

一、电子金属封装、电子陶瓷封装、电子塑料封装、电子环氧树脂材料封装、封装材料与工艺、电子封装设备及先进制造技术、电子封装测试技术设备、电子烧结相关产品与技术等；

二、先进封装与系统集成: 球栅阵列封装、芯片级封装、倒装芯片、晶圆级封装、三维集成及其它各种先进的封装和系统集成技术等;

三、封装材料与工艺: 键和丝、焊球、焊膏、导电胶等互连材料;芯片下填料、粘结剂、薄膜材料、介电材料、基板材料、框架材料、导热材料、绿色电子材料以及其他能够高封装性能和降低成本的新型材料;以及各种各样的封装与组装工艺等 ;

四、封装设计与模拟: 各种新的封装/组装设计 ; 电子封装的电、热、光和机械特性建模、模拟和验证方法;多尺度和多物理量建模等;

五、新兴领域封装: 传感器、执行器、微机电系统、纳机电系统、微光机电系统的封装技术;光电子封装 , CMOS图像传感器封装;封装及集成技术在液晶显示 , 无源元件 , 射频、功率和高压器件 , 及纳米器件等新兴领域的应用等 ;

六、高密度基板及组装技术: 嵌入式无源和有源元件基板技术;高密度互连基板、印刷线路板、高密度高性能基板;及其它能够提高基板密度和性能的各种新型基板技术等 ;

☐ 联系我们 ☐

敬请及时与我们沟通联络 , 获取最新展会信息

联系人Contact : 李先生 150 0190 9485 ( 同微信 )

电话Tel : 021-56802386

电邮Email : [ais021@126.com](mailto:ais021@126.com)